

中国物联网芯片行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2024-2031年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国物联网芯片行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202402/694274.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

当前几乎所有物联网终端都需搭载物联网芯片，在智能手机、PC、智能家居等消费电子的增长颓势之下，物联网芯片越发得到各大半导体厂商和工业制造巨头的重视。总体来看，物联网芯片可以分为两大类。一类是以嵌入式微控制器为主，另一类是具有特定功能的芯片。物联网芯片是物联网设备的重要组成部分，随着物联网快速发展和应用领域的扩大，物联网芯片市场也是不断增长，数据显示，在2022年全球物联网芯片市场规模约为340亿美元，同比增长9.3%。而从企业来看，目前行业参与企业主要包括德州仪器、华为海思半导体、英特尔、高通、中兴微电子、三星集团、紫光展锐和意法半导体等。

全球物联网芯片行业主要参与企业情况

公司简称	成立时间	所属国家	主营业务
德州仪器	1930年	美国	公司是美国德克萨斯州一家半导体跨国公司，以开发、制造、销售半导体和计算机技术闻名于世，主要从事创新型数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售。除半导体业务外，还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。

华为海思半导体	2004年	中国	海思是全球领先的Fabless半导体与器件设计公司，产品覆盖智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧出行、显示交互、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域，在中国、新加坡、韩国、日本、欧洲等地设有12个办事处和研发中心，产品和服务遍布全球100多个国家和地区。
英特尔	1968年	美国	英特尔是半导体行业和计算创新领域的全球领先厂商，主营业务是电脑芯片的研发制造,包括处理器和内存等。此外,公司还涉及了一些其他领域,如物联网、无线通讯和人工智能等。
高通	1985年	美国	高通总部设于美国加利福尼亚州圣迭戈市，公司客户及合作伙伴既包括全世界知名的手机、平板电脑、路由器和系统制造厂商，也涵盖全球领先的无线运营商，高通致力于帮助无线产业链上各方的成员获得成功。
中兴微电子	2003年	中国	经过近30年的发展，中兴微电子已具备复杂SoC芯片前后端全流程设计能力，自主研发并成功商用的芯片达到120多种，产品覆盖ICT产业“云、管道、终端”全领域，服务全球160多个国家和地区，连续多年被评为“中国十大集成电路设计企业”。

三星集团	1938年	韩国	公司是韩国的跨国企业，业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域。
紫光展锐	2013年	中国	公司具备大型芯片集成及套片能力，产品包括移动通信中央处理器，基带芯片，AI芯片，射频前端芯片，射频芯片等各类通信、计算及控制芯片等，场测覆盖全球133+国家和地区，通过全球260+运营商的出货认证，拥有包括荣耀、realme、vivo、三星、摩托罗拉、海信、中兴、京东、银联、格力在内的500多家客户。
意法半导体	1987年	意大利	意法半导体是世界最大的半导体公司之一，主营产品涵盖了多个领域，主要包括了汽车电子、工业和消费者电子产品、物联网和通讯等。

资料来源：公司资料、观研天下整理

从市场占比来看，2022年全球物联网芯片市场占比最高的企业是高通，市场占比为17.8%；其次是英特尔，市场占比为15.2%；第三是三星，市场占比为12.4%，而意法半导体和德州

仪器市场占比分别为9.6%、8.7%。而全球物联网芯片行业中，处在提供商第一梯队主要是高通、英特尔、恩智浦、ARM。

资料来源：观研天下整理

随着物联网的高速发展，物联网芯片正逐渐呈现超过PC、手机芯片等领域趋势，未来其发展潜力也将逐步显现。国内来看，目前国内厂商也在纷纷发力物联网芯片，包括华为海思、中芯国际、台积电、联发科、润欣科技、国科微、力合微、国民技术等公司都在纷纷扩大设备、组件和软件开发方面的创新能力，利用自身优势抢占物联网芯片市场。

从投融资情况来看，2021年之后我国物联网芯片行业相关投融资事件为下降趋势，到2023年我国物联网芯片行业相关投融资事件约13起，已披露投融资金额约14.8亿元。2024年1-2月20日，行业投融资数量共3起，投资金额为1亿元。

资料来源：IT桔子

2023年我国物联网芯片行业共发生投融资事件13起，其中投融资金额最高为4月，投资金额为5亿元。

资料来源：IT桔子

2024年1-2月20日我国物联网芯片行业共发生3起投融资事件，分别为汉天下、聆思智能和犀云科技获得的C轮、A+轮和Pre-A轮投资，金额均未透露。

时间	公司简称	轮次	投资金额
2024-01-17	汉天下	C轮	未透露
2024-01-15	聆思智能	A+轮	未透露
2024-01-02	犀云科技	Pre-A轮	数千万人民币

资料来源：IT桔子（XD）

注：上述信息仅供参考，具体内容请以报告正文为准。

观研报告网发布的《中国物联网芯片行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面

了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国物联网芯片行业发展概述

第一节 物联网芯片行业发展情况概述

一、物联网芯片行业相关定义

二、物联网芯片特点分析

三、物联网芯片行业基本情况介绍

四、物联网芯片行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、物联网芯片行业需求主体分析

第二节 中国物联网芯片行业生命周期分析

一、物联网芯片行业生命周期理论概述

二、物联网芯片行业所属的生命周期分析

第三节 物联网芯片行业经济指标分析

一、物联网芯片行业的赢利性分析

二、物联网芯片行业的经济周期分析

三、物联网芯片行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球物联网芯片行业市场发展现状分析

第一节 全球物联网芯片行业发展历程回顾

第二节 全球物联网芯片行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲物联网芯片行业地区市场分析

一、亚洲物联网芯片行业市场现状分析

二、亚洲物联网芯片行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲物联网芯片行业市场前景分析

第四节 北美物联网芯片行业地区市场分析

一、北美物联网芯片行业市场现状分析

二、北美物联网芯片行业市场规模与市场需求分析

三、北美物联网芯片行业市场前景分析

第五节 欧洲物联网芯片行业地区市场分析

- 一、欧洲物联网芯片行业市场现状分析
- 二、欧洲物联网芯片行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧洲物联网芯片行业市场前景分析

第六节 2024-2031年世界物联网芯片行业分布走势预测

第七节 2024-2031年全球物联网芯片行业市场规模预测

第三章 中国物联网芯片行业产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

第二节 我国宏观经济环境对物联网芯片行业的影响分析

第三节 中国物联网芯片行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规
- 三、主要行业标准

第四节 政策环境对物联网芯片行业的影响分析

第五节 中国物联网芯片行业产业社会环境分析

第四章 中国物联网芯片行业运行情况

第一节 中国物联网芯片行业发展状况情况介绍

- 一、行业发展历程回顾
- 二、行业创新情况分析
- 三、行业发展特点分析

第二节 中国物联网芯片行业市场规模分析

- 一、影响中国物联网芯片行业市场规模的因素
- 二、中国物联网芯片行业市场规模
- 三、中国物联网芯片行业市场规模解析

第三节 中国物联网芯片行业供应情况分析

- 一、中国物联网芯片行业供应规模
- 二、中国物联网芯片行业供应特点

第四节 中国物联网芯片行业需求情况分析

- 一、中国物联网芯片行业需求规模
- 二、中国物联网芯片行业需求特点

第五节 中国物联网芯片行业供需平衡分析

第五章 中国物联网芯片行业产业链和细分市场分析

第一节中国物联网芯片行业产业链综述

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、产业链运行机制
- 三、物联网芯片行业产业链图解

第二节中国物联网芯片行业产业链环节分析

- 一、上游产业发展现状
- 二、上游产业对物联网芯片行业的影响分析
- 三、下游产业发展现状
- 四、下游产业对物联网芯片行业的影响分析

第三节我国物联网芯片行业细分市场分析

- 一、细分市场一
- 二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国物联网芯片行业市场竞争分析

第一节中国物联网芯片行业竞争现状分析

- 一、中国物联网芯片行业竞争格局分析
- 二、中国物联网芯片行业主要品牌分析

第二节中国物联网芯片行业集中度分析

- 一、中国物联网芯片行业市场集中度影响因素分析
- 二、中国物联网芯片行业市场集中度分析

第三节中国物联网芯片行业竞争特征分析

- 一、企业区域分布特征
- 二、企业规模分布特征
- 三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国物联网芯片行业模型分析

第一节中国物联网芯片行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、波特五力模型原理
- 二、供应商议价能力
- 三、购买者议价能力
- 四、新进入者威胁
- 五、替代品威胁
- 六、同业竞争程度
- 七、波特五力模型分析结论

第二节中国物联网芯片行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国物联网芯片行业SWOT分析结论

第三节中国物联网芯片行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国物联网芯片行业需求特点与动态分析

第一节中国物联网芯片行业市场动态情况

第二节中国物联网芯片行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节物联网芯片行业成本结构分析

第四节物联网芯片行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节中国物联网芯片行业价格现状分析

第六节中国物联网芯片行业平均价格走势预测

一、中国物联网芯片行业平均价格趋势分析

二、中国物联网芯片行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国物联网芯片行业所属行业运行数据监测

第一节中国物联网芯片行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节中国物联网芯片行业所属行业产销与费用分析

- 一、流动资产
- 二、销售收入分析
- 三、负债分析
- 四、利润规模分析
- 五、产值分析

第三节中国物联网芯片行业所属行业财务指标分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国物联网芯片行业区域市场现状分析

第一节中国物联网芯片行业区域市场规模分析

- 一、影响物联网芯片行业区域市场分布的因素
- 二、中国物联网芯片行业区域市场分布

第二节中国华东地区物联网芯片行业市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区物联网芯片行业市场分析
 - (1) 华东地区物联网芯片行业市场规模
 - (2) 华南地区物联网芯片行业市场现状
 - (3) 华东地区物联网芯片行业市场规模预测

第三节华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区物联网芯片行业市场分析
 - (1) 华中地区物联网芯片行业市场规模
 - (2) 华中地区物联网芯片行业市场现状
 - (3) 华中地区物联网芯片行业市场规模预测

第四节华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区物联网芯片行业市场分析
 - (1) 华南地区物联网芯片行业市场规模

(2) 华南地区物联网芯片行业市场现状

(3) 华南地区物联网芯片行业市场规模预测

第五节 华北地区物联网芯片行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区物联网芯片行业市场分析

(1) 华北地区物联网芯片行业市场规模

(2) 华北地区物联网芯片行业市场现状

(3) 华北地区物联网芯片行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区物联网芯片行业市场分析

(1) 东北地区物联网芯片行业市场规模

(2) 东北地区物联网芯片行业市场现状

(3) 东北地区物联网芯片行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区物联网芯片行业市场分析

(1) 西南地区物联网芯片行业市场规模

(2) 西南地区物联网芯片行业市场现状

(3) 西南地区物联网芯片行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区物联网芯片行业市场分析

(1) 西北地区物联网芯片行业市场规模

(2) 西北地区物联网芯片行业市场现状

(3) 西北地区物联网芯片行业市场规模预测

第十一章 物联网芯片行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第三节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第四节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第五节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第六节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第七节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十二章 2024-2031年中国物联网芯片行业发展前景分析与预测

第一节中国物联网芯片行业未来发展前景分析

一、物联网芯片行业国内投资环境分析

二、中国物联网芯片行业市场机会分析

三、中国物联网芯片行业投资增速预测

第二节中国物联网芯片行业未来发展趋势预测

第三节中国物联网芯片行业规模发展预测

一、中国物联网芯片行业市场规模预测

二、中国物联网芯片行业市场规模增速预测

三、中国物联网芯片行业产值规模预测

四、中国物联网芯片行业产值增速预测

五、中国物联网芯片行业供需情况预测

第四节中国物联网芯片行业盈利走势预测

第十三章 2024-2031年中国物联网芯片行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国物联网芯片行业进入壁垒分析

一、物联网芯片行业资金壁垒分析

- 二、物联网芯片行业技术壁垒分析
- 三、物联网芯片行业人才壁垒分析
- 四、物联网芯片行业品牌壁垒分析
- 五、物联网芯片行业其他壁垒分析
- 第二节物联网芯片行业风险分析
 - 一、物联网芯片行业宏观环境风险
 - 二、物联网芯片行业技术风险
 - 三、物联网芯片行业竞争风险
 - 四、物联网芯片行业其他风险
- 第三节中国物联网芯片行业存在的问题
- 第四节中国物联网芯片行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2031年中国物联网芯片行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国物联网芯片行业研究综述

- 一、行业投资价值
- 二、行业风险评估

第二节中国物联网芯片行业进入策略分析

- 一、行业目标客户群体
- 二、细分市场选择
- 三、区域市场的选择

第三节物联网芯片行业营销策略分析

- 一、物联网芯片行业产品策略
- 二、物联网芯片行业定价策略
- 三、物联网芯片行业渠道策略
- 四、物联网芯片行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202402/694274.html>